



MSL FPGAs INC 晶片參數

■ 晶片概述

XC1701LPDG8I是来自MSL FPGAs INC美时龙的一款FPGA（现场可编程门阵列）芯片，采用LPDG8封装（8引脚LQFP封装）。该芯片以低功耗、高集成度为特点，适用于消费电子、工业控制、嵌入式系统等场景。以下是其关键信息：

■ 核心参数

逻辑单元：约1700个逻辑单元（具体型号可能对应不同资源规模）。
工作电压：1.2V（典型值，低功耗设计）。封装类型：LPDG8（8引脚LQFP）。
存储资源：可能集成嵌入式存储器（Block RAM）或Flash。
I/O 数量：支持6-8个可编程I/O引脚。

■ 功能特性

低功耗模式：支持动态功耗管理，适用于电池供电设备。
高速接口：兼容 SPI、I2C、UART等通信协议。
工业级可靠性：工作温度范围 -40°C ~ 85°C ，适合严苛环境。
瞬时配置：支持快速启动（毫秒级配置时间）。

■ 应用场景

消费电子：智能家居、便携设备。
工业控制：传感器接口、实时监控。
嵌入式系统：外设扩展、逻辑加速。